

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2026 年 8 月 14 日)

编号：2026-001

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
---------------	--

投资者关系活动主要内容介绍	公司董事会秘书和财务总监首先向参会机构和投资者介绍公司半年度整体经营业绩、报告期内公司经营情况和部分变化，包括主营显示驱动芯片封测业务的产能状况，以及鑫丰科技的经营情况，并重点汇报了合肥晶瑞旺科技有限公司并由其全资控股上海郑隆芯创及新加坡研发中心以构筑专有先进封装研发体系进展。未来，公司核心技术团队将基于深厚的技术积累，加速向系统级先进封装领域迈进，在持续修复主业盈利能力的同时构筑全新的业绩增长极。 整体情况介绍完毕后进入问答环节，公司管理层主要就参会机构和投资者关心的如下问题进行解答和交流： 1、报告期内，公司单季度营收创历史新高，但是利润表现一般，如何公司报告期的业绩表现？ 答：报告期内，公司第二季度实现营收约 5.48 亿元，创单季度历史新高，归母净利润实现 1,782.15 万元（环比第一季度实现扭亏为盈），公司出货规模与市场份额整体处于稳步扩张的态势。对于利润同比有所下滑的业绩表现，主要受到毛利率与费用端多重因素叠加的影响： 首先，在毛利率方面，主要受到三个核心因素的阶段性挤压：一是黄金原材料价格上涨及税率调整，采购成本增加，且黄金现货价格持续走高，公司成本传导存在一定的滞后性；二是产品结构变化，手机端存储芯片涨价一定程度导致终端出货下滑，高毛利的 OLED DDIC 及 CP 测试段订单占比阶段性回落；三是固定成本摊销，一季度春节假期及排产影响导致单位折旧摊销成本上升，拖累了上半年整体毛利率表现。 其次，在费用端及非经常性损益方面，本期计提股份支付费用同比增加约 1,500 万元；存货跌价准备计提同比增加约 1,400 万元；同时受美元汇率波动影响产生汇兑损失 956 万元（上年同期为汇兑收益）。
----------------------	--

	综上所述，公司营收创新高证明了业务基本盘与交付能力的稳固，利润承压主要系阶段性、非结构性的成本与费用因素所致。若手机等终端产品需求复苏，或成本费用端影响因素得到优化，公司盈利能力有望回升。 2、鑫丰科技目前营运情况如何？如何看待存储封测的景气度情况以及后续价格走势？是否能展开说明一下对于未来鑫丰科技的扩产计划？ 答：鑫丰科技是公司拓展存储领域第二增长曲线的重要战略布局方向，受存储芯片景气度影响，产能利用率整体处于较高水平，并正处于积极快速扩充产能的阶段。 3、公司近期围绕先进封装领域积极开展产业布局，能否介绍一下整体项目规划？ 答：合肥晶瑞旺科技有限公司（简称“晶瑞旺”）旗下全资控股上海郑隆芯创微电子有限公司，在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS 先进封装研发产业化项目”，投资总额预计不低于人民币 75 亿元。该平台旨在打造公司专有的下一代先进封装研发体系，聚焦高端与 AI 增量市场需求。晶瑞旺项目是公司迈向“后摩尔时代”核心价值链的关键落子，高度契合公司向高端封测领域延展的长期战略方向。 该项目将集中攻坚先进封装领域的五大关键技术瓶颈：超窄间距凸块键合、超细线路互连高速芯片、超大尺寸芯片系统整合封装、高密度互连，以及精细间距再布线层。作为面向高端移动设备、人工智能伺服器及边缘人工智能应用的先进封装技术平台，HITS 旨在利用基于有机中介层的架构，实现逻辑 SoC、DRAM、LPDDR 及 Wi-Fi 等连接组件在单一封装内的晶圆级平面整合。平台的建成预期将有效实现多种类芯片之间的高效整合，达到缩小封装体积、缩短信号路径与优化时间的目
--	---

	的，并显著提升散热性能与电源效率，赋能系统终端性能的本质提升。 该项目目前处于产线建设阶段，在相关工艺设备安装与综合调试完毕后，公司将积极推进客户验证与产品工程测试以获取市场准入，最终实现产能爬坡与商业化落地，保障各项扩产规划按预期推进。
是否涉及应披露重大信息的说明	否。
附件清单（如有）	无
上传日期	2026 年 08 月 17 日